

Drag & Drop your files here, or [browse](#)



Show

Your Submissions

All of Collection

Search the repository ...

Search

Your submissions

Now showing 1 - 1 of 1

Filters

Status



Date



Reset filters

No Thumbnail
Available

Workflow

Item

Analisis Distribusi Ketebalan Untuk Paket IC TDSON SS08

(2024-07-04) Humam Yafi, Naufal; Havwini,Tian; Mandhalena Manurung,Meilani
Sn Plating adalah suatu proses pelapisan timah yang menggunakan teknik electro-
plating dengan tujuan untuk melapisi logam dengan menggunakan arus listrik dan
larutan elektrolit tertentu. Cpk jig adalah alat yang digunakan untuk membant

Show more

View

Settings